



“中国材料大会2018”会议通知



“中国材料大会2018”定于2018年7月12-16日在福建省厦门市召开，会议由中国材料研究学会发起并主办。分会
场和论坛设置如下：

A. 能源材料

- A-01. 能量转换与存储材料
- A-02. 纳米材料与新能源（国际分会）
- A-03. 核材料
- A-04. 太阳能材料与器件
- A-05. 矿物与油气田材料

B. 环境材料

- B-01. 光催化材料
- B-02. 生态环境材料
- B-03. 环境工程材料
- B-04. 资源材料与循环利用

C. 先进结构材料

- C-01. 粉末冶金
- C-02. 高性能铝合金
- C-03. 先进镁合金
- C-04. 高温合金
- C-06. 金属基复合材料
- C-07. 空间材料科学技术
- C-09. 先进陶瓷材料

D. 功能材料

- D-01. 超材料与多功能材料
- D-02. 多铁性材料

D-03. 非晶与高熵合金

D-04. 极端条件材料与器件

D-05. 功能分子材料与器件

D-06. 先进微电子与光电子材料

D-07. 生物医用材料

D-08. 纳米多孔金属材料

D-09. 纤维材料改性与复合技术

D-10. 高分子材料

D-11. 半导体材料与器件

E. 材料基础研究

E-01. 材料先进制备加工技术

E-02. 材料表征与评价

E-03. 相分离冶金与材料

E-04. 先进凝固科学与技术

E-05. 石油管材及装备材料服役行为与结构安全

E-06. 材料基因工程

Z. 材料模拟、计算与设计

F. 论坛

FA. 两岸三地新材料论坛

FB. 材料教育论坛

FC. 材料科技期刊发展论坛

EM. 新材料、新工艺和材料测试技术展览会

注册费标准（不含版面费，会议期间食宿自理）：

2018年5月31日前注册交费（以银行印鉴为准）：

非学生：RMB 1800元

学 生：RMB 1400元

2018年5月31日后注册交费：

非学生：RMB 2000 元

学 生：RMB 1600 元

付款方式1：在线支付：请登录会议网站，注册后进行在线支付。

付款方式2：银行汇款

单位名称：中国材料研究学会

开户银行：北京银行魏公村支行

银行帐号：0109 0303 2001 2011 1009 376

欢迎从事材料科学研究、开发和产业化的专家、学者、教授、科技工作者、学生、政府有关的管理部和领导、企业家及其它相关人员参会。

会议注册及提交稿件等详细信息请登录会议网站 <http://cmc2018.medmeeting.org>

